

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION

合肥晶合集成電路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2249)

修訂公司章程

本公告由合肥晶合集成電路股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

茲提述本公司日期為2026年6月30日的招股章程(「招股章程」)、日期為2026年8月6日有關部分行使超額配股權及穩定價格期結束的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公司於2026年7月10日就全球發售發行216,167,000股H股。於2026年8月6日，超額配股權獲部分行使，涉及合共10,886,900股H股。該等H股於2026年8月11日根據部分行使超額配股權發行及配發。本公司的已發行股份總數增加至2,234,645,597股股份，每股面值人民幣1.00元。因此，本公司將註冊資本由人民幣2,007,591,697元增至人民幣2,234,645,597元，並對本公司公司章程(「公司章程」)有關條款進行修改。

公司章程的修訂詳情如下：

修訂前	修訂後
公司章程名稱： 合肥晶合集成電路股份有限公司章程(草案)	公司章程名稱： 合肥晶合集成電路股份有限公司章程
第三條 公司於2022年5月9日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)註冊，首次向社會公眾發行人民幣普通股501,533,789股，於2023年5月5日在上海證券交易所(以下簡稱「證券交易所」)科創板上市。 公司於2026年5月19日經中國證監會備案，並於●年●月●日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准，首次公開發行境外上市外資股●股，於●年●月●日在香港聯交所主板上市。……	第三條 公司於2022年5月9日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)註冊，首次向社會公眾發行人民幣普通股501,533,789股，於2023年5月5日在上海證券交易所(以下簡稱「證券交易所」)科創板上市。 公司於2026年5月19日經中國證監會備案，並經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准，首次公開發行境外上市外資股(以下簡稱「H」股)216,167,000股，並超額配售了10,886,900股H股，前述H股分別於2026年7月10日和2026年8月11日在香港聯交所主板上市。……
第六條 公司註冊資本為人民幣●萬元，總股數為●萬股，均為普通股股份。	第六條 公司註冊資本為人民幣223,464.5597萬元，總股數為223,464.5597萬股，均為普通股股份。
第二十條 公司的股份均為普通股，每股面值人民幣壹元。其中A股普通股2,007,591,697股，H股普通股●股。……	第二十條 公司的股份均為普通股，每股面值人民幣壹元，其中A股普通股2,007,591,697股，H股普通股227,053,900股。……

修訂前	修訂後
第一百四十一條 提名委員會由3名董事組成，……並就下列事項向董事會提出建議： …… (三)提名、任免或重新任免董事以及董事(尤其是主席及總經理)繼任計劃董事； ……	第一百四十一條 提名委員會由3名董事組成，……並就下列事項向董事會提出建議： …… (三)提名、任免或重新任免董事以及董事(尤其是主席、總經理(總裁)及聯席總經理(聯合首席執行官))繼任計劃； ……
第一百四十四條 公司設總經理1名—聯席總經理2名，設執行副總經理／資深副總經理／副總經理若干名。……	第一百四十四條 公司設總經理(總裁)1名或聯席總經理(聯合首席執行官)2名，設執行副總裁／資深副總裁／副總裁若干名。……

除上述公司章程修訂外，章程中所有「總經理」改為「總經理(總裁)」，「聯席總經理」改為「聯席總經理(聯合首席執行官)」，「執行副總經理／資深副總經理／副總經理」改為「執行副總裁／資深副總裁／副總裁」，而其他條文維持不變。

根據於2025年9月16日舉行的股東會通過的議案，本公司股東會已授予董事會或其獲授權人士根據全球發售情況對公司章程作出修訂。上述修訂中涉及H股發行及註冊資本變更的相關條款(即公司章程名稱、第三條、第六條及第二十條)自2026年8月24日經董事會審議通過後生效，其餘條款尚需經股東會審議。

上述公司章程修訂將登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。本公司將依據適用法律法規，向中華人民共和國相關政府及監管機關辦妥上述公司章程修訂事項之工商登記、備案及其他相關手續。公司章程的最終版本須以市場監督管理部門核准的內容為準。公司章程中文版本與英文版本如有任何不一致，概以中文版本為準。

一份載有(其中包括)公司章程修訂的詳情的通函及股東會通告，將於切實可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
Nexchip Semiconductor Corporation
合肥晶集成電路股份有限公司
執行董事兼董事長
蔡國智先生

香港，2026年8月24日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、陳小蓓女士、郭兆志先生及邱文生先生；及(iii)獨立非執行董事安廣實教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。